

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前回购价格上限：130.84 元/股（含）
- 调整后回购价格上限：93.77 元/股（含）
- 价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 14 日（2023 年年度权益分派除权除息日）

一、回购股份的基本情况

2024 年 2 月 4 日，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购用于股权激励的回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月；本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），其中，用于股权激励的回购资金为不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；用于维护公司价值及股东权益的回购资金为不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 130.84 元/股。其中，用于维护公司价值及股东权益的回购期限已于 2024 年 5 月 3 日届满，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重

回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-012）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）（公告编号：2024-013）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展暨部分回购用途实施期限届满的公告》（公告编号：2024-036）。

二、本次调整回购股份价格上限的原因

公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。根据《公司2023年度资本公积转增股本预案的议案》，在实施权益分派股权登记日之前，因回购股份等致使公司总股本发生变化的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-042）。

根据《回购报告书》，如在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整

根据《回购报告书》的约定，本次回购股份价格上限由不超过人民币130.84元/股（含）调整为不超过人民币93.77元/股（含），调整后的回购股份价格上限将于2024年6月14日生效，具体的价格调整公式如下：

调整后的回购股份价格上限 = （调整前的回购股份价格上限 - 每股现金红利） ÷ （1 + 流通股份变动比例）。

根据《公司2023年度资本公积转增股本预案的议案》，公司实际分派的现金红利为0元/股，实际分派的流通股份变动比例为0.40。

由于本次权益分派为差异化权益分派，前述公式中的“流通股份变动比例”应为根据总股本摊薄调整后计算的流通股份变动比例，即：

流通股份变动比例 = （参与分派的股本总数 × 实际分派的流通股份变动比例）

\div 总股本 = $(62,217,725 \times 0.40) \div 62,939,380 \approx 0.3954$ (保留四位小数)。

因此, 调整后的回购股份价格上限 = $(130.84 - 0) \div (1 + 0.3954) \approx 93.77$ 元/股 (含, 保留两位小数)。

根据《回购报告书》, 本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元 (含), 不超过人民币 6,000 万元 (含)。其中, 用于股权激励的回购资金为不低于人民币 1,500 万元 (含), 不超过人民币 3,000 万元 (含); 用于维护公司价值及股东权益的回购资金为不低于人民币 1,500 万元 (含), 不超过人民币 3,000 万元 (含)。用于维护公司价值及股东权益的回购期限已于 2024 年 5 月 3 日届满。调整回购价格上限后, 按照本次用于股权激励的回购金额上限人民币 3,000 万元、回购价格上限 93.77 元/股测算, 回购数量约为 319,932 股, 回购股份比例约占公司转增实施完成后总股本的 0.36%。按照本次用于股权激励的回购金额下限人民币 1,500 万元、回购价格上限 93.77 元/股测算, 回购数量约为 159,966 股, 回购比例约占公司转增实施完成后总股本的 0.18%。

具体回购股份的资金总额、数量及占公司总股本比例, 以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、其他事项说明

除上述调整外, 公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定, 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施, 同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日